

证券代码：688183

证券简称：生益电子

生益电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系 活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☒路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称或 人员姓名	易米基金、国海证券、国融证券、达晨财智、青岛鹿秀投资、东方嘉富资产管理、尚融资本、鼎锋明道等80余名投资者 本次投资者关系活动采取线上以及现场会议形式，现场调研机构均签署调研承诺函。在交流活动中，我司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
时间	2026年8月17日、2026年8月18日
地点	线上会议、生益电子会议室现场会议
上市公司 接待人员	董事长：邓春华 财务总监：黄乾初 市场部负责人：黄炜
投资者关系活动 主要内容介绍	一、介绍公司基本情况 公司简要介绍公司基本情况，包括公司基本经营情况、主要产品应用领域、主要财务情况等内容。 二、互动交流的主要问题 1、公司2026年上半年业绩情况 2026 年上半年，公司紧抓行业高景气机遇，秉持“市场引领、双轮驱动”的经营理念，锚定中高端赛道持续深耕。在巩固前期市场拓展成果的基础上，加快产能释放、深化技术升级、强化质量管控，经营业绩实现较快增长，高端产品收入占比稳步提升，核心竞争力持续提升。2026 年上半年公司实现营业收入 57.84 亿元，同比增长 53.46%；实现归属于母公司所有者的净利润 11.11 亿元，同比增长 109.36%；综合毛利率 34.31%，同比提升 3.92 个百分点。 2、公司产品结构情况 随着公司不断完善产品布局，持续推进“抓住机会，实现市场覆盖新突破”的市场战略，2026年上半年公司产品主要分为服务器/计算机板、

投资者关系活动主要内容介绍	通信网络设备板、汽车电子板以及其他板（包括消费电子、医疗、航空航天等）等，其中服务器/计算机板收入占比为59.14%，通信网络设备板占比为29.54%，汽车电子板以及其他板收入占比为11.32%。 3、公司本次募投项目情况和进度 东莞人工智能计算HDI生产基地建设项目属于公司现有产品的升级迭代和产能扩张，该项目主要生产5阶及以上高阶HDI板（含mSAP工艺HDI产品），达产后年产能将达到16.72万平方米。项目已完成厂房土建工程设计、审图和招标等工作，并于2026年5月底进入土建工程基础施工阶段，计划2028年试生产。公司将加快项目建设，以满足日益增长的高端市场需求。 吉安智能制造高多层算力电路板项目计划年产能70万平方米，规划产品以平均16层的高多层板为主，项目实施地点为现有厂房的四层、五层全部区域和一层已分隔的独立区域，目前公司已使用自有资金进行前期的建设，项目第一阶段在2026年6月实现全流程贯通试生产，助力公司中高端产能扩充；同时，公司已提前启动项目第二阶段建设工作，力争提前至2026年底前投入试生产，为公司抢抓高端市场、持续优化产品结构提供支持。 4、公司对未来PCB市场规模以及行业发展前景的预期 PCB行业是全球电子元件细分产业中产值占比最大的产业，也是电子信息技术的核心基础组件。根据Prismark2026年一季度报告数据，2030年全球PCB产值将增长至1,446.10亿美元，2025年至2030年全球PCB产值的预计年复合增长率达11.0%。其中，服务器/数据存储和通信网络是增速最快的细分市场，且服务器/数据存储已经超越消费电子成为PCB下游第一大应用领域。 其中受益于全球AI基础设施（包含服务器设备、存储设备、AI加速卡等）市场规模正快速扩张，由此带动的AI服务器等高算力设备出货量迅速提高。根据Prismark数据，预计2029年全球服务器/数据存储领域PCB产值规模将达到225.46亿美元，2024年-2029年将以15.6%的复合增长领跑PCB其他应用领域。 AI数据中心的快速扩张亦相应带动高端交换机和高速光模块等高速网络基础设施的需求增长，根据Prismark数据，预计到2029年，全球通信设备领域PCB产值将达到151.55亿美元，2024-2029年将保持平均每年10.2%的复合增长。 未来公司对PCB行业的发展保持信心，将通过深耕服务器和通信网络
---------------	---

投资者关系活动主要内容介绍	等市场，紧抓本轮行业高景气机遇。 5、目前原材料价格增长及原材料供应紧张对公司业绩的影响 2025年第4季度起，受铜价等外部因素以及上游供应商产能受限等影响，原材料价格出现上涨，本轮原材料涨价属于行业共同面对的现状，原材料的涨价将带动产业链各个环节价值传导。同时公司通过持续强化内控管理，进一步优化产品结构及提升质量管理水平，促进了公司业绩增长。2026年上半年，公司毛利率及净利率均实现同比增长。 后续公司将持续关注主要原材料以及大宗商品等的价格走势，及时分析市场供需变化，并根据订单情况、库存情况以及原材料和大宗商品价格波动预测，动态调整公司的供应策略，将原材料价格增长对公司业绩影响降低。 6、公司下游客户开发的情况 公司秉承“市场引领，双轮驱动”的发展战略，不断与服务器/计算机、通信网络、汽车电子等下游领域知名客户持续积极接触或建立合作关系。目前公司客户储备丰富，且主要客户均为下游行业的头部企业，已涵盖众多境内外头部AI客户，同时公司也持续推进新客户的认证和开发工作，新客户认证进度良好。 7、公司目前产能及未来产能规划情况 截至2026年6月末，公司设计现有产能为246万平方米。对于未来的产能扩张，公司目前有多个扩产项目在建，合计在建产能114.62万平方米。除本次再融资的两个募投项目以外，公司其他扩产项目主要为2个自有资金项目，其中智能算力中心高多层高密互连电路板项目二期按计划推进建设与设备部署，并已于2026年上半年内逐步投入使用；泰国工厂一期（大算力高端电路板）项目目前进入设备安装与调试的关键阶段，全力推进项目2026年第三季度试生产和运行。 公司将根据宏观环境和行业发展情况，特别是AI相关技术和市场需求变化，结合公司实际经营发展需要，持续优化产品规划和产能布局。 8、公司目前的研发实力 公司高度重视技术及产品研发创新，坚持以市场需求为导向，关注上下游技术变革，并依托高素质的研发团队，实现产品的技术更新，具备对下游需求良好的前瞻性、快速响应能力及产品开发能力。截至2026年6月30日，公司累计授权有效专利364项，其中境内发明专利304项、实用新型
---------------	---

	59项、境外发明专利1项；拥有软件著作权28项；主导或参与制定国家标准2项、行业标准7项、团体标准25项；公司累计完成19项科技成果鉴定，其中14项国际先进、5项国内领先；衍生国家重点新产品3项、省级重点/自主创新/火炬计划产品3项、广东省名优高新技术产品16项。未来，公司将持续强化技术创新和技术储备，以确保公司的技术研发实力和技术创新能力在同行业中保持先进水平。 注：公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单 (如有)	无
日期	2026年8月19日